



平成 21 年 12 月 22 日

各 位

会社名 株式会社日立ハイテクノロジーズ  
代表者名 執行役社長 大林 秀仁  
コード番号 8036 東証 1 部・大証 1 部

会社名 株式会社ルネサス テクノロジ  
代表者名 取締役会長 塚本 克博

## 吸収分割契約の締結に関するお知らせ

株式会社日立ハイテクノロジーズ(執行役社長：大林 秀仁／以下、日立ハイテク)および株式会社ルネサス テクノロジ(取締役会長：塚本 克博／以下、ルネサス)は、平成 21 年 10 月 28 日に「半導体製造装置事業の再編について」として、ルネサスの 100%子会社である株式会社ルネサス東日本セミコンダクタ(取締役社長：村山 幸男／以下、ルネサス東日本セミコンダクタ)山梨工場(山梨県南アルプス市)の半導体製造装置事業を、日立ハイテクの 100%子会社である株式会社日立ハイテクインスツルメンツ(取締役社長：川崎 義直／以下、日立ハイテクインスツルメンツ)に対して、事業承継(吸収分割による)することを発表していますが、本件に関し、本日、ルネサス東日本セミコンダクタ及び日立ハイテクインスツルメンツ間の吸収分割契約と、吸収分割当事者ならびに日立ハイテクおよびルネサス間での本件に係る最終契約を締結いたしました。本件に関する概要、背景及び効力発生日は、次のとおりです。

### 1. 吸収分割の概要

ルネサス東日本セミコンダクタを吸収分割会社、日立ハイテクインスツルメンツを吸収分割承継会社として、ルネサス東日本セミコンダクタが半導体後工程装置事業を日立ハイテクインスツルメンツに吸収分割します。

### 2. 吸収分割の背景

これまで、ルネサス東日本セミコンダクタの半導体後工程製造装置は、同社にて開発・製造を行い、グローバル販売の大半を日立ハイテクが担当していたため、市場環境の変化に柔軟に対応し、顧客ニーズを反映した新製品開発の迅速化を図るべく、日立ハイテクとルネサスは、半導体後工程装置事業の開発から製造・販売・サービスを一体運営すべきとの認識で一致しました。また、日立ハイテクインスツルメンツの電子部品実装システムと半導体関連製造装置事業にて培った技術力・製品開発力との相乗効果により、一層優れた製品を市場に投入し、事業拡大を図る目的で、日立ハイテクとルネサスは本吸収分割を行うことに合意しました。これにより、日立ハイテクは、市場拡大が期待される半導体後工程装置事業の事業基盤の確立・強化を目指します。一方ルネサスは、マイコン事業をコアコンピタンスとした事業強化のための経営リソースの有効活用を進め、事業基盤の強化と経営基盤の安定化を図っていきます。

### 3. 吸収分割効力発生日

本吸収分割の効力発生日は、平成 22 年 4 月 1 日とします。

[報道関係問い合わせ先]

株式会社日立ハイテクノロジーズ 社長室 [担当：加藤、松本]

〒105-8717 東京都港区西新橋一丁目 24 番 14 号

電話 (03) 3504-3258 (ダイヤルイン)

株式会社ルネサス テクノロジ 広報・宣伝部 [担当：小林、上原]

〒100-0004 東京都千代田区大手町二丁目 6 番 2 号 日本ビル

電話 (03) 6756-5555 (ダイヤルイン)

以 上